



Research and
Development Center

一季报渐近收官，Mini LED 引领创新

电子行业周报

2021 年 04 月 25 日

证券研究报告

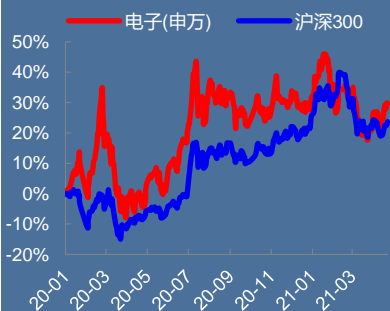
行业研究

行业周报

电子

投资评级 看好

上次评级 看好



数据来源：万得，信达证券研发中心

方 竞 电子行业首席分析师

执业编号：S1500520030001

邮 箱：fangjing@cindasc.com

李 少 青 电子行业分析师

执业编号：S1500520080004

邮 箱：lishaoqing@cindasc.com

刘 志 来 研究助理

邮 箱：liuzhilai@cindasc.com

童 秋 涛 研究助理

邮 箱：tongqiutao@cindasc.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO., LTD

北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

邮编：100031

一季报渐近收官，Mini LED 引领创新

2021年04月25日

本期内容提要：

➤ **一季报渐近收官，期待上半年景气表现。**随着时间来到月底，一季报即将进入收官阶段。从已发布的季报的公司来看，受益于下游需求爆发，叠加晶圆厂产能紧缺，半导体板块景气度高启，如韦尔股份、卓胜微、北方华创等公司均有不俗表现。

而在 VR 销量爆发的推动下，歌尔股份亦取得亮眼成绩，预计上半年实现归母净利润 15.6-18.0 亿，同比增长 100%-130%。我们认为 VR 内容逐步完善，不断有知名工作室加入 VR 游戏开发的行列，未来如《半条命：Alyx》之类的 VR 大作有望逐渐涌现，以优质内容做高硬件基数，进而吸引更多的开发者入驻，形成 VR 生态上的循环增长。

面板方面，伴随物料供给受限叠加旺季效应，本月面板价格加速上行。根据 Witsview 数据，TV 面板 4 月价格环比上涨 6-12%，IT 面板环比上涨 5-8%，涨幅均扩大 1-3%。我们认为京东方和 TCL 科技作为行业龙头，拥有对上游产业链的强大话语权，将优先获得物料供应，面板双雄有望畅享涨价超预期后的业绩释放弹性，建议重点关注。

➤ **苹果 Mini LED 产品表现亮眼，有望引领产业创新。**4 月 21 日凌晨，苹果发布了搭载 Mini LED 屏幕的新款 12.9 英寸 iPad Pro，是全球首款使用 Mini LED 技术的平板电脑，也是苹果继 2019 年的 Pro Display XDR 显示器之后，第二次在产品中使用 Mini LED 技术。

参数方面，此次苹果以 10000 颗 Mini LED 芯片、2596 个 Local dimming 分区，打造出具备极强显示效果的 iPad，其对比度高达 100 万比 1，峰值亮度 1600 尼特。

价格方面，新款 Mini LED 版本 iPad 以 1099 美元的价格起售（8499 元人民币），较以往的 12.9 寸 iPad Pro 价格（7899 元人民币），仅提高 600 元的售价，可见苹果推广 Mini LED 的决心与力度，我们预计下半年的 macbook 亦将搭载 Mini LED，有望进一步带动 Mini LED 应用的热潮。

此外，搭载 Mini LED 的新款 iPad Pro 有望为 LED 产业链带来可观增量需求。以价值量较高的 LED 芯片端为例，若假设今年 12.9 英寸新款 iPad Pro 出货占 iPad 整体出货 10%，则将约有约 500 万台整机出货，带来 5 万 kk Mini LED 芯片需求，折合约 100 万片外延片产能（等效 4 寸片），为 LED 芯片厂商带来显著业绩增量，据行家说产业研究中心测算，本次发布的 iPad Pro 对应 Mini LED 芯片的销售额预计将达到 1-1.5 亿美元，占苹果 LED 芯片供应商晶元光电年产值的 30% 左右。此外，由于 Mini LED 背光正处于初期导入应用阶段，且其产品定位于高端、具有较高的附加值，因此 Mini LED 芯片盈利性也较好。

我们认为，苹果以接近平价的方式，在常规旗舰中引入高分区 Mini LED 背光技术，将引领显示技术新趋势，其他厂商也有望在今年陆续推出 Mini LED 平价产品，这势必将加速 Mini LED 背光的渗透，并带动上下游相关产业链复苏，行业有望进入景气上行期。

➤ **投资评级：**苹果新款 iPad Pro 发布有望引领产业链创新、带动 Mini LED 的应用热潮，并催生一系列投资机会，我们看好 Mini LED 全产业链，建议重点关注 LED 行业优质标的及面板龙头公司，如芯片制造厂商：三安光电、华灿光电等；面板龙头：京东方 A、TCL 科技；封测厂商：国星光电、瑞丰光电等；模组代工厂商：利亚德、洲明科技、兆驰股份等；设备厂商：ASM Pacific、新益昌；PCB 厂商：鹏鼎控股等。

此外，其他半导体板块在国产替代的推动下同样需求旺盛；终端品牌的 IOT 创新、互联网拓张，也是今年确定性极高的投资机遇。建议关注以下优质标的，**功率半导体：**中车时代电气、士兰微、斯达半导、华润微、新洁能、闻泰科技。**半导体设备：**北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微、华峰测控、ASM Pacific。**半导体设计：**韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、

- 思瑞浦、晶丰明源、富瀚微；**电子品牌**：小米集团、联想集团、传音控股、安克创新；**消费电子**：立讯精密、歌尔股份、长盈精密、舜宇光学。
- **风险因素**：市场竞争加剧；疫情持续，影响需求；技术渗透不及预期；中美贸易纠纷风险，半导体景气度下行风险。

目录

附录一：上周市场回顾.....	5
附录二：上周科技新闻回顾.....	6
附录三：近期重要行业数据整理更新.....	11
附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒.....	12

表目录

表 1: 重要指数和价格变化.....	5
---------------------	---

图目录

图 1: 电子行业子板块周涨跌幅 (%).....	5
图 2: 电子行业个股周涨跌幅前五后五 (%).....	5
图 3: 全球晶圆设备支出 YOY 变化.....	11
图 4: 1Q19~4Q20 全球整体 EDA 产业市场规模与增速.....	11
图 5: 1Q21 全球 PC 出货量分布 (百万台).....	11
图 6: 2019~2025 年全球 AI 用半导体市场规模预估 (亿美元).....	11
图 7: 日厂被动元件全球出货额变化 (百亿日元).....	11
图 8: 全球 Top 5 NB 品牌出货量变化 (百万台).....	11

附录一：上周市场回顾

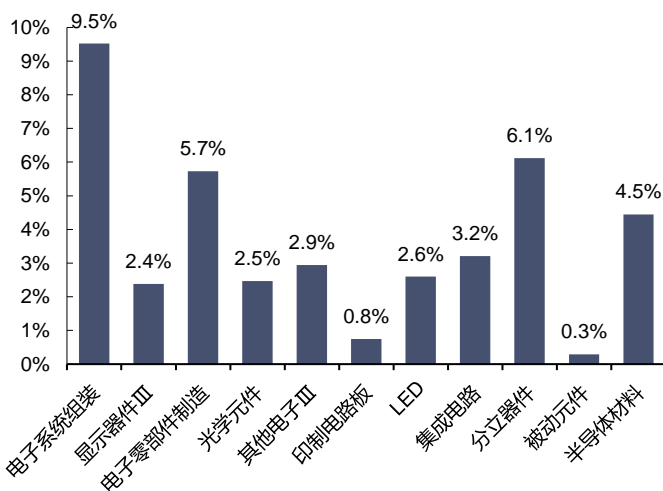
电子板块上周上涨 4.2%，跑赢沪深 300 指数 0.8 个百分点。年初至今电子板块下跌 1.2%，跑赢沪深 300 指数 0.3 个百分点。上周电子行业子版块涨幅分别为电子系统组装 9.52%，显示器件Ⅲ 2.38%，电子零部件制造 5.73%，光学元件 2.47%，其他电子Ⅲ 2.94%，印制电路板 0.75%，LED 2.60%，集成电路 3.21%，分立器件 6.12%，被动元件 0.29%，半导体材料 4.45%。就个股而言，上周涨幅位于前列的分别是歌尔股份 26.2%，朗明微电子 20.5%，美迪凯 20.2%，奥普特 19.5%，富满电子 18.9%。

表 1：重要指数和价格变化

全球股指	指数	周度涨跌幅	年初至今涨跌幅	原材料	价格	涨跌幅
沪深 300	5135.5	3.4%	-1.5%	LME 铝	2369.0	2.3%
上证综指	3474.2	1.4%	11.2%	LME 铜	9551.5	3.7%
中小板指	9228.1	5.4%	14.4%	DCE 塑料	8100.0	-3.5%
创业板指	2994.5	7.6%	8.8%	LME 镍	16365.0	0.0%
道琼斯	34043.5	-0.5%	7.4%	LME 锡	26850.0	0.9%
SOX	3197.0	-1.7%	11.4%	LME 锌	2850.5	-0.2%
纳斯达克	14016.8	-0.3%	12.7%	人民币汇率		
A 股电子	4676.8	4.2%	-1.2%	美元	6.493	-0.54%
恒生科技	21496.2	1.2%	2.3%	欧元	7.802	-0.15%
台湾加权	17300.3	0.8%	17.4%	100 日元	6.014	0.12%
台湾 IT	24262.9	-0.3%	17.1%	新台币对美元	28.082	-0.66%

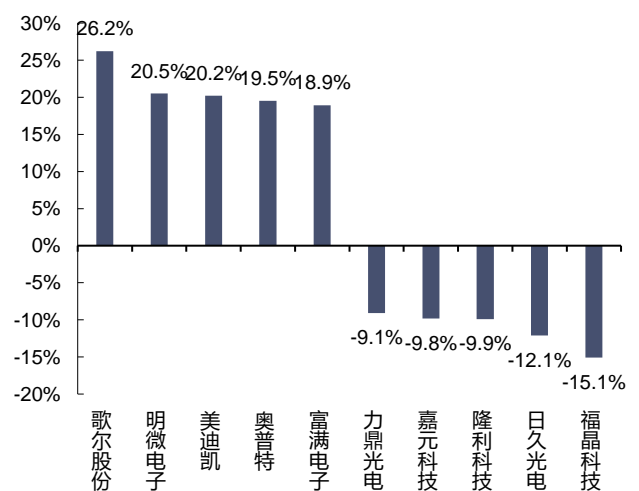
资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 1：电子行业子板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 2：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

附录二：上周科技新闻回顾

1、消费电子

可折叠手机出货量

据 Digitimes 报道，华为计划在 2H21 推出 3 款新的可折叠智能手机，在 2021 年 2 月推出了可折叠的 Mate X2。Digitimes Research 估计，得益于新折叠手机的面世，到 2021 年，可折叠智能手机的全球出货量可能达到 700 万部，高于一年前的 280 万部。（闪信息）

全球智能手机出货量

据 Strategy Analytics，全球智能手机出货量在 1Q21 为 3.4 亿部，同比增长+24%，是自 2015 年以来的最高增长。智能手机市场的反弹是由设备老化的消费者的健康需求以及中国供应商对 5G 的强劲推动推动的。在全球范围内，排名前 5 位的供应商合计在 1Q21 占据了 76% 的市场份额，高于一年前的 71%。（闪信息）

苹果发布 Airtag

苹果发布 AirTag，它的位置跟踪信标可以帮助苹果设备所有者通过苹果的“查找我的”（Find My）应用程序找到丢失的物品。AirTag 本身是小型的，圆形的跟踪设备，可以连接到个人物品，例如钱包、袋子或钥匙。它们的价格为每套 29 美元，或一包四个的价格为 99 美元。（闪信息）

3 月手机销量 Top 20 揭晓 苹果、三星品牌最强势

2021 年 3 月手机市场销售成绩出炉！市调机构 GFK 针对全台实体通路调查的数据统计显示，今年 3 月台湾手机市场的销售量约 40.4 万支，较 2 月减少 14%，整体销量自 2020 年 12 月开始往下递减，以本月进榜的机型来看，万元以下单机就占一半，整体销售额也较上月少 17.4 亿，仅次于 2020 年 2 月 COVID-19 疫情爆发时产值下降的 17.8 亿，产量与产值不断下降。本月热销单机榜也有明显的变化，三星急起直追，以 Galaxy A42（6+128G）挤下 iPhone 11（128G）来到第六名、连同 Galaxy A32、S21+完整规格全数进榜，抢下七席与苹果战成平手。（中时新闻网）

2021 年第一季度 5G 手机报告

2020 年，5G 手机市场发展迅速，不同功能不同价位的 5G 手机纷纷登场，5G 手机市场规模持续扩大，5G 手机活跃设备数和市占率不断增长。截至 2020 年年末，5G 手机在智能手机市场的占有率已经达到 8.5%。（1）华为持续领跑市场 苹果强势加入战局。（2）5G 手机正在普及和下沉。（3）女“果粉”占比超 7 成 iPhone12 最受欢迎。（手机技术资讯）

TCL 推出折叠辊概念设备：第一款可折叠和可滚动的手机

TCL 推出了可折叠和可滚动手机，TCL 的第一款具有灵活屏幕的设备将于今年晚些时候面世。TCL 折叠辊是一个外文件夹（即屏幕保持在外面），并且有一个可滚动的机制来扩展展开的屏幕。该公司将下一代铰链和机械技术相结合，以支持这两项行动。（Yole Reports）

2、半导体

TrendForce: Q2 DRAM 价格最高可望涨 30%

TrendForce 最新调查报告显示,已经拟定交易中主流模组 DDR4 1G*8 2666Mbps 均价的季涨幅已接近 25%。此外,服务器 DRAM 价格涨幅也同步扩大,加上原先已预期 Q2 专业 DRAM DDR3、DDR4、手机 DRAM 与 Graphics DRAM 价格都将高涨,预估 Q2 整体 DRAM 均价涨幅将自原先的 13~18%,上调至 18~23%,而实际涨幅依照 DRAM 原厂产品比重不同也有差异。(国际电子商情)

TrendForce: 预估 GCP、AWS 服务器建置年增 25~30% 成推动全球服务器需求关键助力

根据 TrendForce 研究显示,资料中心弹性的价格策略与服务的多元性,直接驱动近两年企业对于云端应用需求;若以服务器供应链角度分析,上述转变已促使供应链模式由 ODM Direct 代工逐渐取代传统服务器品牌厂的商业模式。目前全球大型公有云服务商为寡占市场格局,以北美为首的 Microsoft Azure(Azure)、Amazon Web Service(AWS)与 Google Cloud Platform(GCP) 拥全球五成以上的公有云市占率,而其中又以 GCP 与 AWS 的资料中心建置最为积极,预估两者今年伺服器建置将年增 25~30%,而 Azure 的采购规模则紧追在后。(台湾行业协会)

联发科成为台积电 4 纳米和 3 纳米的第一家客户

联发科新一代 5G 旗舰芯片由外界原本预期的 5 纳米制程生产,升级到 4 纳米,同时开出 3 纳米产品,成为台积电 4 纳米和 3 纳米的第一家客户。联发科这款 4 纳米 5G 旗舰芯片,已经手握 OPPO、vivo 及小米等客户订单,芯片可望在 3Q22 末、4Q22 初量产。(闪信息)

明年可满负荷运作, 52.5 亿元赛晶亚太嘉善 IGBT 项目 9 月将量产

据浙江融媒体消息,赛晶亚太半导体科技(浙江)有限公司总经理张强表示,预计在今年 6 月底或者 7 月初就可以进行试生产,9 月份可以实现量产。计划到明年,企业可以实现满负荷运作。赛晶亚太半导体科技(浙江)有限公司建设年产 IGBT 功率器件 200 万件项目,位于嘉善经济技术开发区,总投资 52.5 亿元,一期投资 17.5 亿元,计划建设 2 条 IGBT 芯片生产线,5 条 IGBT 模块封装测试生产线,年产 200 万件 IGBT 功率器件,达产后预计产值超 20 亿元。(集微网)

SK 海力士已组建晶圆厂设备研发团队

韩国存储芯片制造商 SK 海力士,已在内部组建了晶圆厂设备研发团队,由公司高层直接领导,还聘请了外部专家。(半导体行业观察)

日本制造商对芯片的需求创下两年来新高

路透社调查显示,由于电子市场的强劲需求和有利的汇率条件提振了出口商的前景,日本制造商的信心在 4 月升至两年多以来的最高水平。(半导体行业观察)

联发科跃居全球第八半导体供应商

根据全球市场信息咨询公司 Gartner Inc. 的消息,台湾智能手机 IC 设计公司联发科荣获 2020 年全球第八大半导体供应商的称号。联发科的收入比去年同期增长了 38.1%,至 2020 年为 109.9 亿美元。(半导体行业观察)

中芯国际出售中芯长电股份，作价 3.97 亿美元！

4 月 22 日，中芯国际发布公告，表示拟转让所持控股子公司 SJ Semiconductor Corporation 的全部股本权益，约占目标公司已发行股本总额 55.87%；本次 总交易对价合计约为 397 百万美元，录得交易收益约 231 百万美元（未经审计）。（半导体行业观察）

台媒：台积电南京厂扩产 28nm，旨在解决汽车芯片危机

据台媒联合报报道，台积电昨天举行临时董事会，通过斥资 28.87 亿美元，扩充南京厂产能，并切入七年来未曾扩建的 28nm 制程，规划新增四万片产能，今年下半年开始量产，2023 年中达到四万片全产目标。（半导体行业观察）

一季度我国芯片相关企业注册量同比增长 302%

企查查数据显示，目前我国共有芯片相关企业（包括产业链上下游各个环节）7.41 万家，2020 年新注册企业 2.28 万家，今年一季度新增企业 8679 家，同比增长 302%。从地区分布来看，目前广东省以 2.52 万家企业高居第一，江苏、浙江分列二三位，而深圳则是排名第一的城市。最新数据显示，2020 年新注册 2.28 万家，今年一季度同比增长 302%。（半导体行业观察）

花旗：Nvidia 收购 Arm，接近宣布失败

随着英国政府在周一宣布，计划以国家安全为由干预英伟达对 Arm 的收购。对此，花旗集团的分析师重新考虑了英伟达收购 CPU 和 GPU 开发人员的计划。观察家认为，既然 Nvidia 推出了自己基于 Arm 架构的数据中心 CPU，那么获得批准购买 Arm 的可能性就大大降低了。（半导体行业观察）

哈勃科技入股北京晟芯，持股 10%

4 月 16 日，北京晟芯网络科技有限公司发生工商变更，注册资本从 350 万元变更为 388.89 万元，哈勃科技向北京晟芯认缴出资额约 38.89 万元，目前持有北京晟芯 10.00% 股权，为北京晟芯的第四大股东。（全球半导体观察）

英特尔公布 Q1 财报，营收 186 亿美元与去年持平

4 月 22 日，英特尔于美股盘后公布 2021 年第一季度财报，第一季度，英特尔 non-GAAP 营收与去年持平，为 186 亿美元；毛利率年减 6.1% 至 58.4%；营运利润率年减 6.7% 至 32.8%；non-GAAP 净利年减 6% 至 57 亿美元。

分业务单元看，客户端计算事业部营收同比增长 8% 至 106 亿美元；数据中心事业部营收同比下降 20% 至 56 亿美元；物联网事业部营收同比增长 4% 至 9.1 亿美元；自动驾驶汽车子公司 Mobileye 营收年增 48% 至 3.8 亿美元；可编程解决方案事业部营收同比下降 6% 至 4.9 亿美元；非易失性存储解决方案集团营收年减 17% 至 11 亿美元。（全球半导体观察）

上游晶圆厂或涨价 15%，MCU 大厂盛群半导体宣布暂停接单

4 月 23 日消息，日前，MCU 大厂盛群半导体宣布自 21 日起暂停接受 2022 年订单。

由于半导体供应链紧张导致的全线涨价，IC 设计厂如盛群普遍面临着对上游厂商产能及价格掌握不明的情况，因此不得不暂停接单。

在公告中，盛群亦表示，上游晶圆厂及包装厂通知近期将有另一波涨价，涨价幅度在 15%-30%。此外，晶圆厂五月上旬将提供 2022 年生产片数，在确定可获得的产能后，盛群将公布 2022 年的接单规则；预计 5 月中旬前恢复接受 2022 年订单。（全球半导体观察）

ASML 公布 Q1 财报，净销售额达 44 亿欧元，预计全年营收增长 30%

本周三，荷兰半导体设备商 ASML 公布了 Q1 主要财务数据，今年首季该公司净销售额达 43.6 亿欧元（约合人民币 344 亿元），毛利率为 53.9%。第一季净利润为 13.3 亿欧元，较上年同期的 3.9 亿欧元大增近 2.5 倍。ASML 预计，第 2 季度营收将增至 40-41 亿欧元，毛利率约为 49%。预计今年营收有望成长约 30%，较之前的“两位数”“成长有所提升”。该公司还表示，预计全年毛利率将在 51-52% 之间。（全球半导体观察）

无锡华虹集成电路一期扩能，投资 52 亿元、月产能达 6.5 万片

4 月 19 日，无锡市发展和改革委员会网站公布了无锡华虹集成电路一期扩能项目情况。华虹半导体（无锡）有限公司计划总投资 52 亿元，当年计划投资为 52 亿元。项目建设起止年限为 2021 年，将形成一条工艺等级 90-65/55nm、月产能达到 6.5 万片的 12 英寸特色工艺集成电路芯片生产线。（爱集微）

南亚科拟投资近 700 亿元建设 12 英寸先进晶圆厂

4 月 20 日，南亚科正式宣布，规划于新北市泰山南林科技园区兴建一座双层无尘室 12 寸先进晶圆厂。根据南亚科新闻稿，此座厂房总投资金额约为新台币 3,000 亿元（约合人民币 696 亿元），将采用南亚科自主研发的 10 纳米制程技术生产 DRAM 芯片，及规划建置 EUV 极紫外光微影生产技术，月产能约为 45,000 片晶圆。此座先进晶圆厂，预估以 7 年分 3 阶段投资，计划于 2021 年底动工，2023 年底完工，2024 年开始第一阶段量产。（科技新报）

3、汽车电子

日本工作机械工业会：日本机床对华 3 月订单额增至 3.3 倍

4 月 20 日发布的 3 月日本机床订单额（确定值）显示，面向中国的订单额增至上年同期的 3.3 倍，达到 373 亿日元，是自 2017 年 11 月起 3 年零 4 个月以来的最高水平。由于纯电动汽车（EV）增产和基础设施投资旺盛，制造业的设备投资热情高涨。（日经中文网）

华为 2021 年在智能汽车研发上的投资将达到 10 亿美元

华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军表示，华为 2021 年在研发上的投资将达到 10 亿美元。华为与车企开展跨界合作的首个产品极狐阿尔法 S 华为 HI 版已正式亮相。目前，华为携手 200 多家产业伙伴共同发展。华为智能驾驶总裁苏箐表示，除北汽外，与广汽、长安合作的系列车型将从 4Q21 起陆续推出，1H22 起会有大量车型上市。（闪信息）

Microchip 推出首款获得车规级单芯片解决方案 可用于大型超宽触摸屏

Microchip Technology（美国微芯科技公司）宣布推出触摸屏控制器 maXTouch®MXT2912TD-UW，可简化电动汽车（EV）、高级驾驶员辅助系统（ADAS）和高档汽车中常见的超宽屏系统的开发过程。该控制器为行业首个通过汽车认证的单芯片解决方案，支持最大 45 英寸的显示屏和极宽的宽高比，同时支持液晶显示器（LCD）和有机发光二极管（OLED）显示技术。（盖世汽车）

日产因芯片短缺减产，800名英国工人闲置

日产汽车公司下个月将削减在日本的几家工厂的生产，这是全球半导体短缺对汽车制造商的最新打击。消息人士称，日本第三大汽车制造商将在5月10日至19日之间将其在九州的工厂闲置八天，另外两家国内组装工厂：Oppama工厂和位于九州的日产沙泰工厂，将在5月10日至28日之间取消为期15天的夜班，而To木的第四家工厂将在下个月闲置10天原计划外说。日产发言人说：“由于（全球芯片）短缺，日产正在调整生产，并正在采取必要的行动以确保回收。”（半导体行业观察）

华为发布4D雷达，全面进军智能汽车

在2021年上海国际车展前夕，华为以“专新致智”为主题，举办HI新品发布会，重磅发布了包括4D成像雷达、AR-HUD、MDC810在内的新一代智能化部件和解决方案。（半导体行业观察）

4、面板/LED/PCB等

富士康将缩减在威斯康星州的液晶显示器（LCD）工厂的计划

富士康缩减在威斯康星州的液晶显示器（LCD）工厂的计划，称其预计将投资近4年前承诺的100亿美元的一小部分。合同规定，富士康现在计划投资至多6.72亿美元，并在2025年之前创造1,454个工作岗位，以获得8,000万美元的奖励。该公司此前同意在2032年之前投资多达100亿美元，并雇用13,000人，以有资格获得28.5亿美元的奖励。（闪信息）

玻纤电子纱：产品连续涨价，创近年新高，行业景气度有望延续

玻纤电子纱，细分产品2400tex直接纱价格已涨至6100元/吨，创近年新高，基于当前紧张的供需格局，后市仍有提涨预期。（PCB信息网）

TCL计划在2023年前开始生产OLED电视面板，使用喷墨打印技术

TCL在最近的一次新闻发布会上说，该公司计划在2023年开始生产OLED电视面板。这些OLED面板将使用喷墨打印过程打印。2020年，TCL向日本喷墨印刷开发商和生产商JOLED投资1.87亿美元，并签署了联合开发OLED电视印刷技术的协议。（Yole Reports）

LG在广州增设OLED生产，每月新增3万张面板

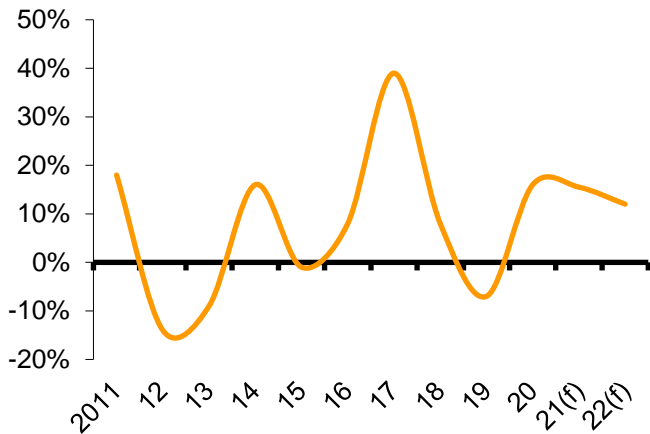
LGD对广州地区的OLED屏幕面板生产进行了进一步的投资，在此次的投资扩产之后，广州地区的OLED面板生产可以在原先基础上每月多生产3万张。（群智咨询）

面板涨价、芯片短缺，三星液晶电视价格预计上涨10-15

受到电视面板涨价、芯片短缺影响，三星将打响液晶电视涨价第一枪，4月22日中国台湾地区的三星新品发布会预计将宣布调涨10%到15%。（群智咨询）

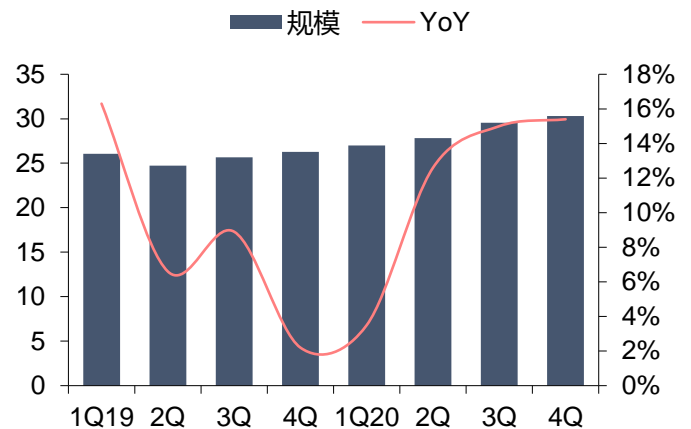
附录三：近期重要行业数据整理更新

图 3：全球晶圆设备支出 YOY 变化



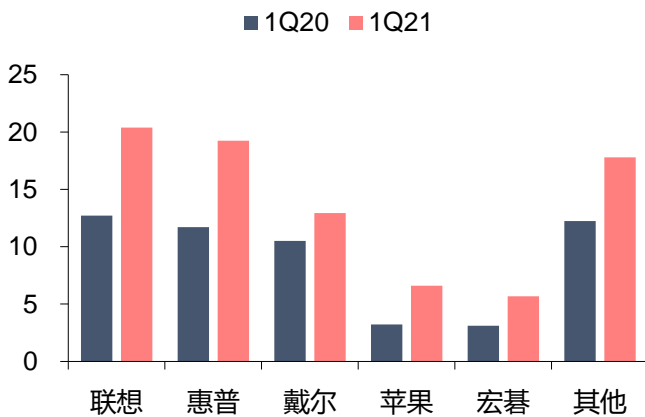
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 4：1Q19~4Q20 全球整体 EDA 产业市场规模与增速



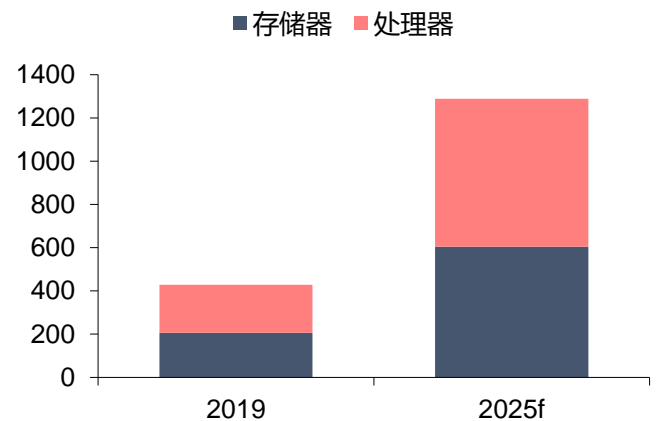
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 5：1Q21 全球 PC 出货量分布 (百万台)



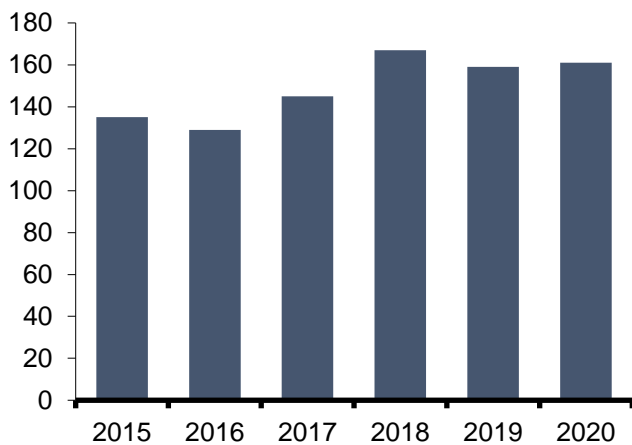
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 6：2019~2025 年全球 AI 用半导体市场规模预估 (亿美元)



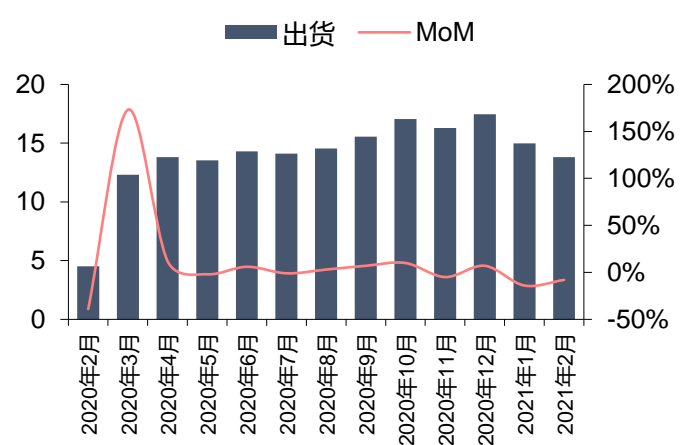
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 7：日厂被动元件全球出货额变化 (百亿日元)



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 8：全球 Top 5 NB 品牌出货量变化 (百万台)



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒

【顺络电子】更新了 2020 年年度报告。2020 年度公司实现营业收入 34.77 亿元，比上年同期增长 29.09%；实现归属于上市公司股东净利润 5.88 亿元，比去年同期增长 46.50%。

【大华股份】发布了减资公告。公司对 65 名不再符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 102.89 万股进行回购注销。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的 29.96 亿股减少至 29.95 亿股。

【水晶光电】发布了关于控股股东股权质押的公告。公司控股股东星星集团持有公司股份 1.24 亿股，占公司总股本的 10.16%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 1.03 亿股，占其持有公司股份总数 83.24%，占公司总股本的 8.46%。

【沪硅产业】发布了 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书。本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，不超过 7.44 亿股。

【卓胜微】发布 2021 年一季报，实现营收 11.83 亿元，同比增长 162.37%；实现归母净利 4.92 亿元，同比增长 224.34%。

【韦尔股份】发布 2021 年一季报，实现营收 271.93 亿元，同比增长 20.07%；实现归母净利 10.41 亿元，同比增长 133.84%。

【沪电股份】发布 2021 年一季报，实现营收 17.47 亿元，同比增长 10.44%；实现归母净利 2.21 亿元，同比增长 3.20%。

【明微电子】发布 2021 年一季报，实现营收 2.02 亿元，同比 134.93%；归母净利 0.66 亿元，同比增长 392.30%。

【水晶光电】发布 2021 年一季报，实现营收 8.66 亿元，同比增长 45.18%；实现归母净利 0.96 亿元，同比增长 20.71%。

【大华股份】发布 2021 年一季报，实现营收 51.14 亿元，同比增加 46.06%；实现归母净利 3.48 亿元，同比增长 9.33%。

【扬杰科技】发布 2021 年一季报，实现营收 9.42 亿元，同比增长 93.37%；实现归母净利 1.55 亿元，同比增长 179.70%。

【圣邦股份】发布 2020 年年报，实现营收 11.97 亿元，同比增长 50.98%；实现归母净利 2.89 亿元，同比增长 64.03%。

【歌尔股份】发布 2021 年第一季度报告。公司第一季度实现营业收入 140.28 亿，同比增长 116.68%；净利润 9.66 亿，同比增长 228.41%。

【歌尔股份】发布 2021 年半年度业绩预告。公司预计上半年实现净利润 15.61 亿至 17.96 亿，同比增长 100% 至 130%。

【歌尔股份】发布关于分拆所属子公司歌尔微电子股份有限公司至创业板上市的预案。歌尔股份拟将其控股子公司歌尔微分拆至深交所创业板上市。本次分拆完成后，歌尔股份股权结构不会发生重大变化，且仍将维持对歌尔微的控制权。

【立讯精密】发布 2020 年年度报告。公司实现营业收入 925.01 亿元，同比增长 47.96%；实现归属于母公司所有者的净利润 72.25 亿元，同比增长 53.28%。

【韦尔股份】发布关于控股股东部分股权质押的公告。控股股东虞仁荣先生持有公司股份 2.73 亿股，占公司总股本的 31.50%；本次质押 770 万股后，虞仁荣先生累计质押股份为 1.45 亿股，占其持股比例的 53.20%。

研究团队简介

方竞，西安电子科技大学本硕连读，近5年半导体行业从业经验，有德州仪器等外企工作经历，熟悉半导体及消费电子产业链。同时还是国内知名半导体创业孵化平台IC咖啡的发起人，曾协助多家半导体公司早期融资。2017年在太平洋证券，2018年在招商证券，2020年加入信达证券，任电子行业首席分析师。所在团队曾获19年新财富电子行业第3名；18/19年《水晶球》电子行业第2/3名；18/19年《金牛奖》电子行业第3/2名。

李少青，武汉大学硕士，2018年加入西南证券，2020年加入信达证券，覆盖半导体产业链。

刘志来，上海社会科学院金融硕士，2020年加入信达证券，覆盖消费电子产业链。

童秋涛，复旦大学资产评估硕士，2020年加入信达证券，从事电子行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
全国销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiuyue@cindasc.com
华北	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北	刘晨旭	13816799047	liuchenxu@cindasc.com
华北	欧亚菲	18618428080	ouyafei@cindasc.com
华北	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华北	魏冲	18340820155	weichong@cindasc.com
华东副总监 (主持工作)	杨兴	13718803208	yangxing@cindasc.com
华东	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华东	孙斯雅	18516562656	sunsiya@cindasc.com
华东	张琼玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华南总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南	王之明	15999555916	wangzhiming@cindasc.com
华南	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com
华南	焦扬	13032111629	jiaoyang@cindasc.com
华南	江开雯	18927445300	jiangkaiwen@cindasc.com
华南	曹曼茜	18693761361	caomanqian@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	买入 ：股价相对强于基准 20% 以上；	看好 ：行业指数超越基准；
	增持 ：股价相对强于基准 5%~20%；	中性 ：行业指数与基准基本持平；
	持有 ：股价相对基准波动在±5% 之间；	看淡 ：行业指数弱于基准。
	卖出 ：股价相对弱于基准 5% 以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。